



持續創新改善 全員追求卓越

法人說明會

股票代號：6207

2025/12/23

LASER TEK TAIWAN CO., LTD.

免責聲明

本報告內容係依現有資訊而做成，上述說明中的財務或相關資訊可能包含一些對本公司及子公司未來前景的說明，這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響，致使最後結果與原先的說明迥異，是以本公司特此聲明，本報告中的內容，僅為資訊流通之目的而公佈，並非投資建議，本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。



公司簡介

成立日期：1988 年 9 月 9 日

資 本 額：新台幣 796,799 仟元

董 事 長：鄭再興 先生

員工人數：集團員工約 300 人

雷科 - 昆山



雷科 - 東莞



雷科-新加坡

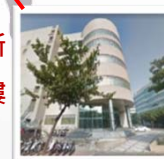


新竹分公司



高雄臨廣總公司

高雄新生大樓



2025年前三季營運成果



合併綜合損益表

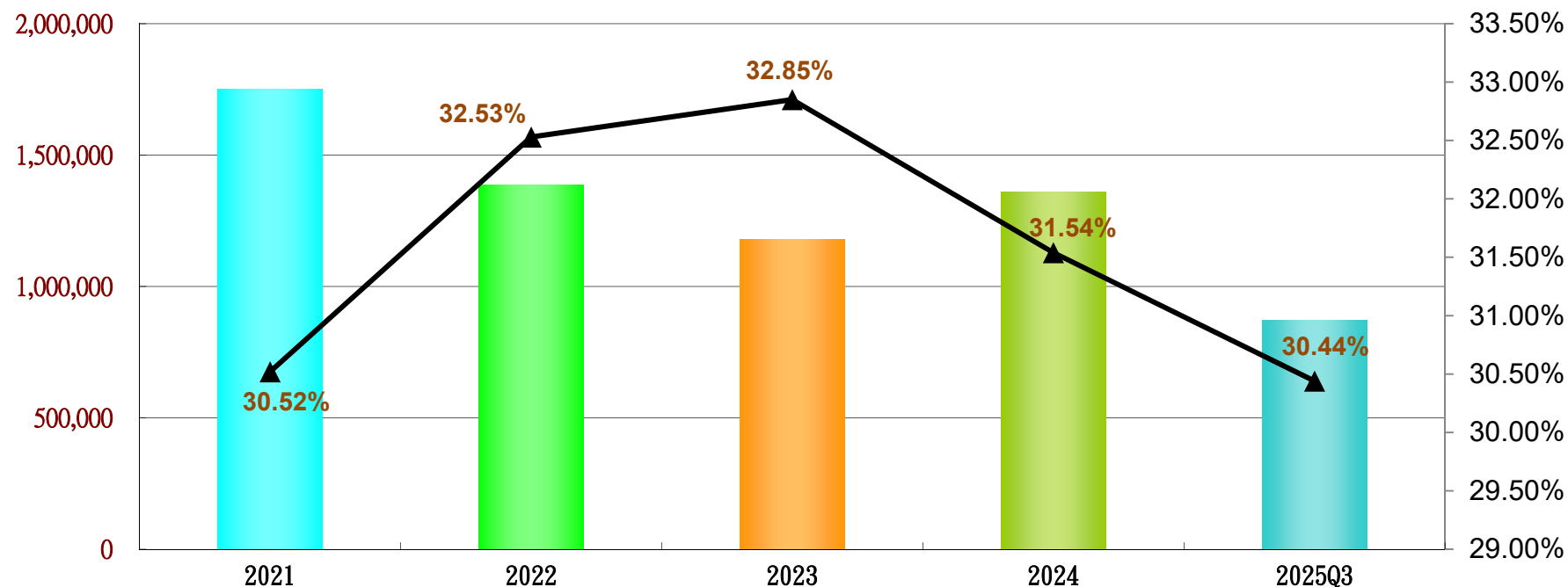
單位：新台幣仟元

| 項目 | 2025 3Q | 2024 3Q | 年差異% |
|------------------|---------|---------|---------|
| 營業收入淨額 | 872,294 | 935,808 | -6.79% |
| 營業毛利率 | 30.44% | 32.22% | -5.52% |
| 營業費用 | 216,994 | 239,291 | -9.32% |
| 營業淨利(損) | 48,500 | 62,262 | -22.10% |
| 營業淨利率 | 5.56% | 6.65% | -16.39% |
| 營業外收入及支出 | 21,244 | 90,656 | -76.57% |
| 歸屬於母公司業主之本期淨利(損) | 55,759 | 127,891 | -56.40% |
| 純益率 | 6.39% | 13.62% | -53.08% |
| 每股盈餘(新台幣元) | 0.7 | 1.61 | -56.52% |



集團營收與毛利率

單位：新台幣仟元



| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025Q3 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 集團營收 | 1,751,466 | 1,386,770 | 1,177,816 | 1,361,184 | 872,294 |
| 集團毛利率 | 30.52% | 32.53% | 32.85% | 31.54% | 30.44% |

產品與技術

 **LASER-TEK** 全球佈局雷科品牌，聚焦核心光電技術，拓展利基藍海市場，提供完整服務方案



雷科產品事業群

60%



設備事業 (Laser & Metrology Equipments)

LASER 製程、檢測設備

COWOS 設備

40%



SMD捲裝材料事業 (Surface Mount Device Packaging Materials)

被動元件 捲裝材料

半導體元件 捲裝材料



能源事業 / GERMAGIC防疫系列產品

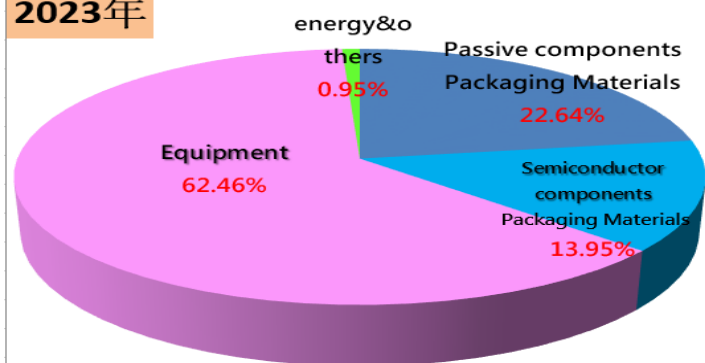
太陽能相關

空氣清淨機

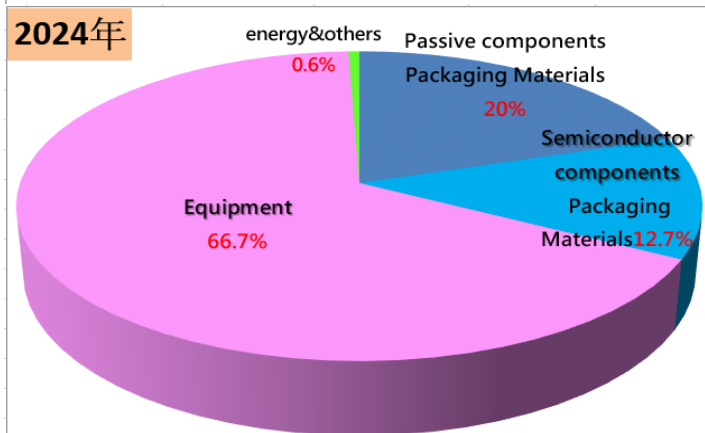
GERMAGIC防疫產品

公司產品項目佔比

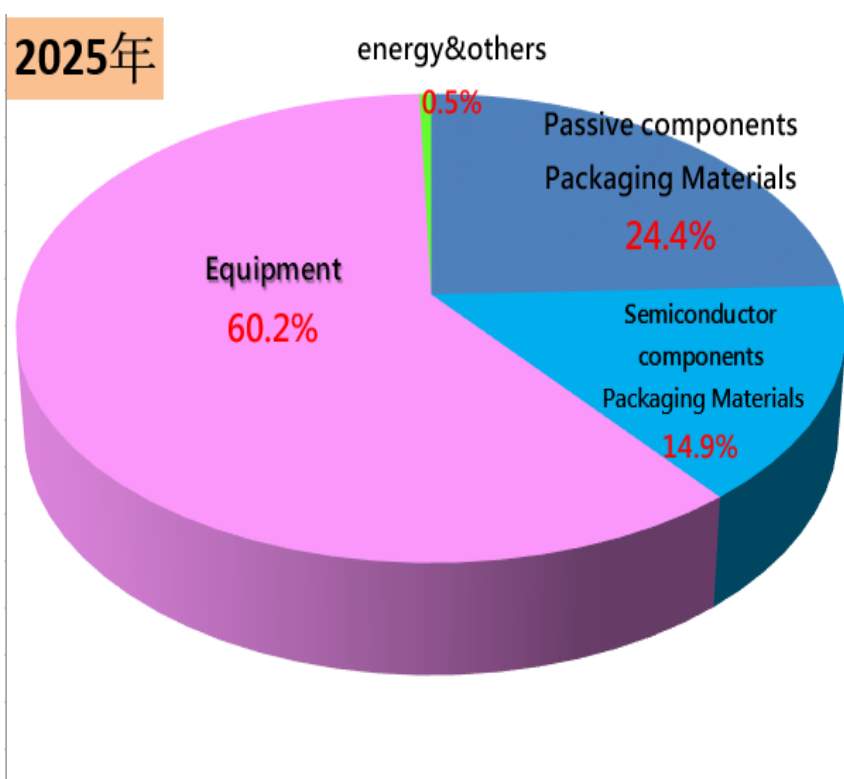
2023年



2024年



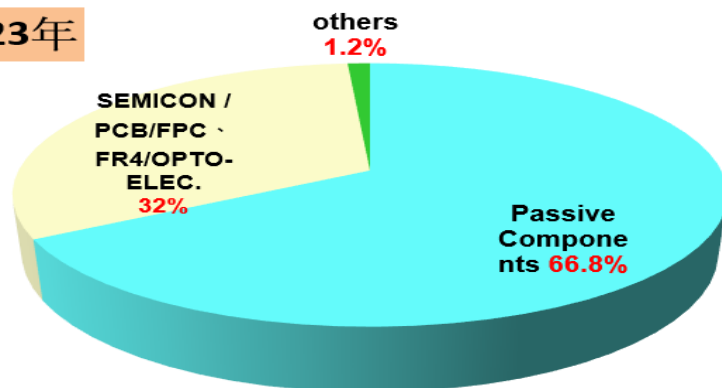
2025年



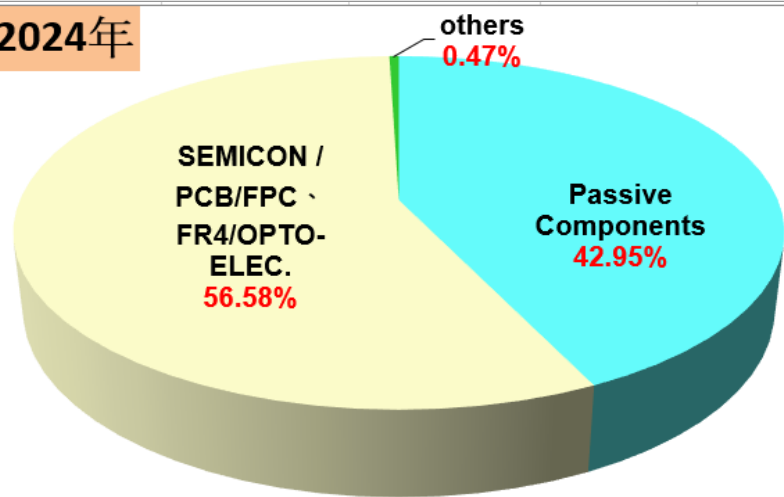
追求卓越

產品產業別佔比

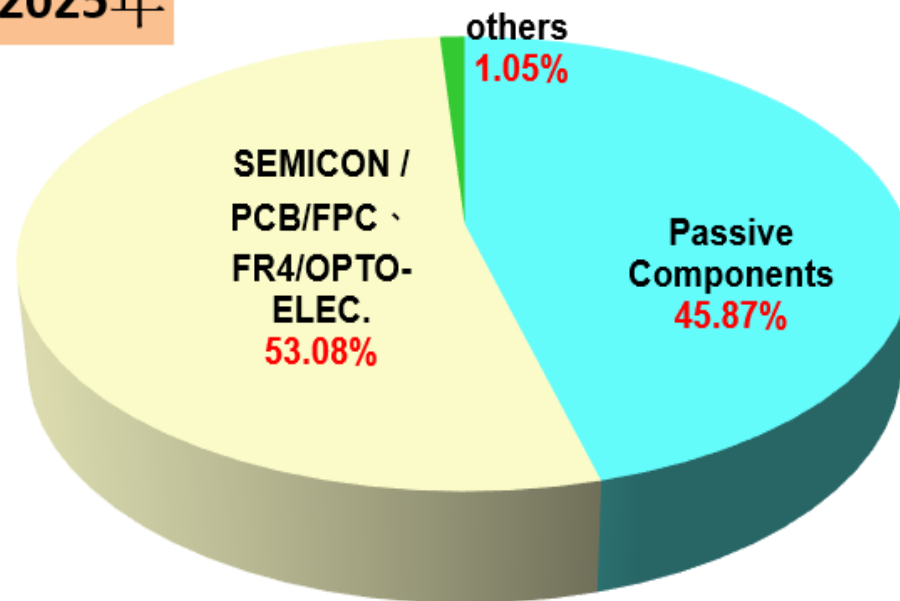
2023年



2024年



2025年

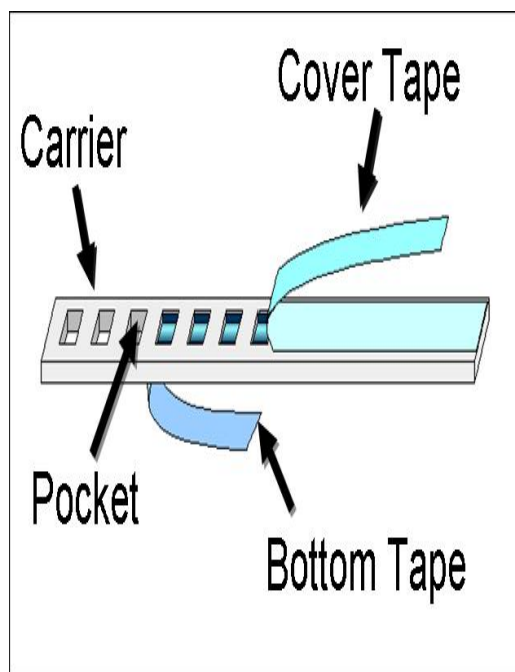


市場，提供完整服務方案



➤ SMD 捲裝材料事業 (Surface Mount Device Packaging Materials)

被動元件 捲裝材料



分條紙帶

LV-SA紙帶由7層處女紙漿所製成



打孔紙帶

特殊孔穴開發，滿足各種尺寸需求



上膠帶

具絕佳的抗靜電效果



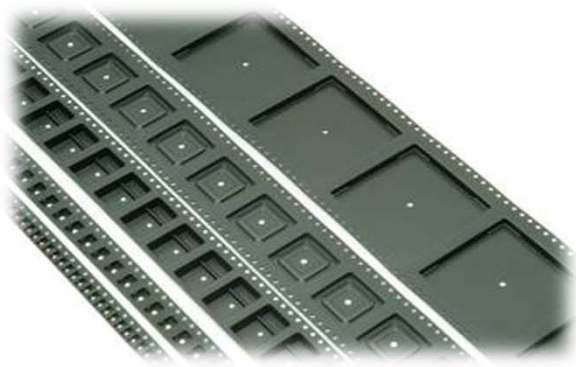
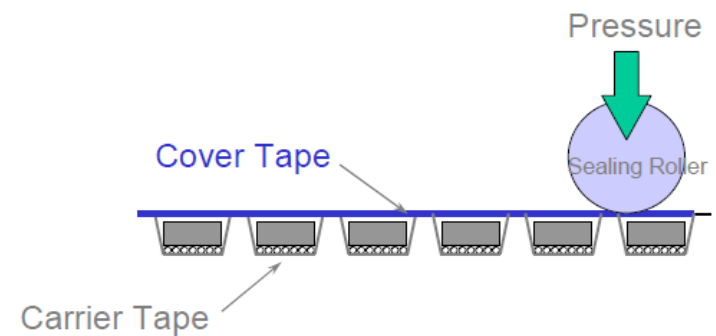
下膠帶

以米紙、塗佈密封物及聚乙烯，抗靜電

➤ SMD 捲裝材料事業 (Surface Mount Device Packaging Materials)

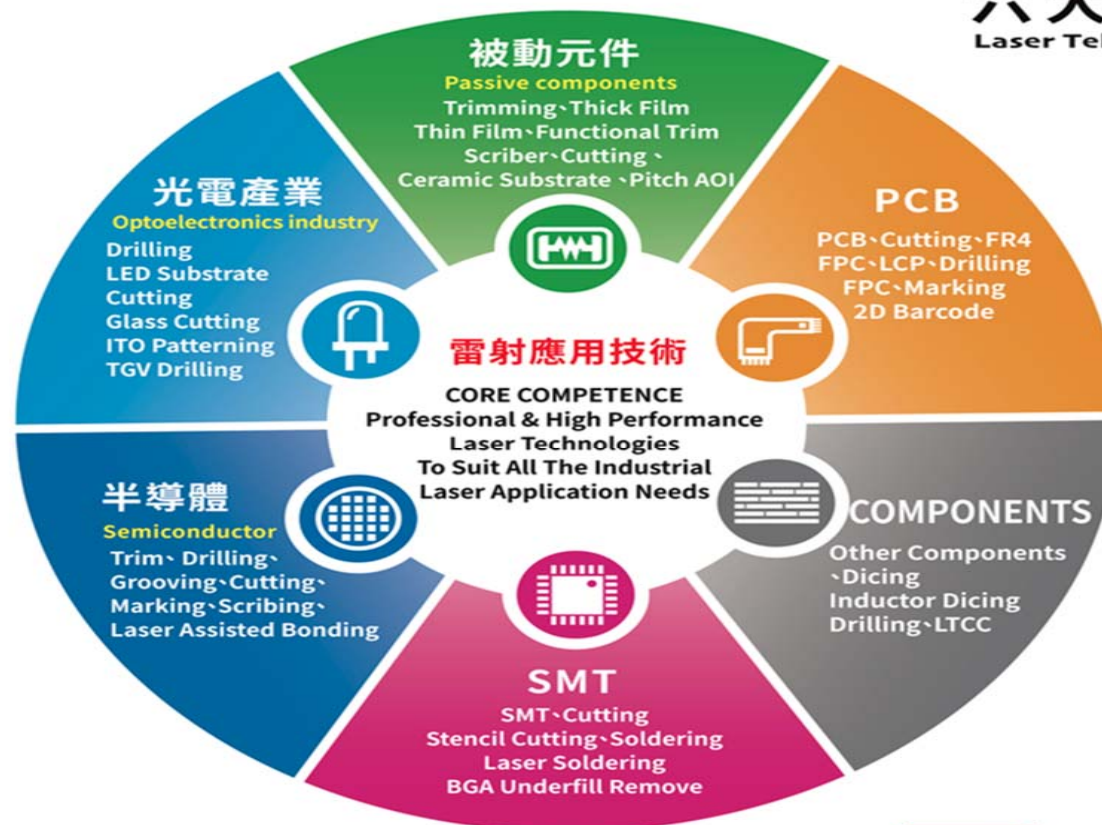
半導體 捲裝載帶

- Carrier Tape為：IC半導體、電子被動元件、LED產品等包裝捲帶，其材質最主要為PC、PS ...等塑膠原料。



設備事業群

六大核心技術 Laser Tek Core Technologies



產品諮詢表單



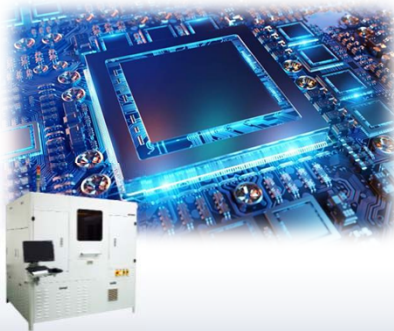
產品DM下載



雷科官方網站

➤ 四大核心領域

半導體



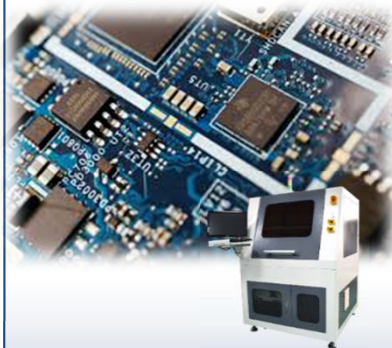
- Wafer trim
- CoWoS檢測
- TSV
- SiC cutting
- TGV
- OSAT封裝

載板



- FR4車用電子
- 氮化鋁基板鑽孔切割
- AI運算基板
- 雷射乾蝕刻
- 伺服器厚板鑽孔

元件



- Thick film
- Thin film(高精度)
- Functional trim
- socket座切割

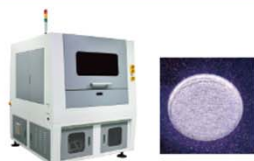
AI應用



- AI 缺陷檢查
- AI 鑽石切割
- AI GPU除膠

半導體領域 雷射相關設備--- 前段切割鑽孔/中段測試/後段封裝

晶圓製造 Wafer Manufacture



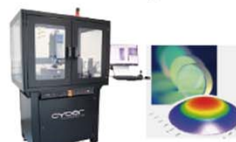
TSV 飛秒鑽孔機 TSV Femto Drilling

特殊光學套件，進行矽晶圓穿孔與盲孔冷加工
Special Optical Modules for Cold Processing of Silicon Wafers with Through-Holes and Blind Holes.



SiC 飛秒切割機 SiC Femto Cutting

特殊光學套件，進行SiC削蝕冷加工切割
Special Optical Modules for SiC Etching and Cold Laser Cutting Process.



Cyber 設備 Cyber Equipment

高階2D/3D非接觸式雷射掃描設備
High-end 2D/3D Non-contact Laser Scanning Equipment.

中段測試 Mid-stage Testing



Wafer Trim

透過光學鏡組，進行對SiC削蝕
Etching of SiC Through Optical Lens.



Functional Trim

混成電路IC功能修調，高精度量測，精密修調
Hybrid Circuit IC Function Trimming, High-Precision Measurement, and Trimming.

後段封裝 Back-end Process



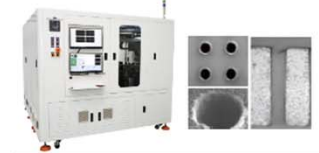
FR4 & ABF Laser Drilling and Cutting

封裝基板層間導通孔 (Via Hole)
ABF 層微孔鑽孔 Substrate 外形切割/分板
多層結構材料精密開窗與去除



Wafer Marking

IC Marking, Wafer Marking.



RF High Frequency Substrate

高頻RF散熱載板 - 低軌衛星 (LEO) 應用



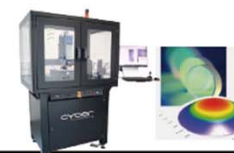
Laser Deflash

Lead frame 修整去毛邊
四點對位漲縮補償
Lead Frame Deburring,
Four-Point Alignment with Expansion
and Contraction Compensation.



FOPLP

玻璃基板去除膠體
Glass Substrate Adhesive Removal.

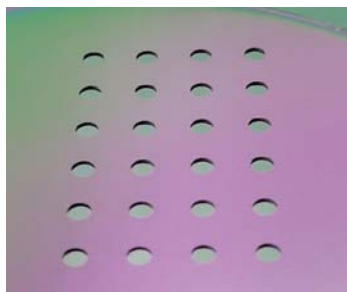


Cyber 設備 Cyber Equipment

高階2D/3D非接觸式雷射掃描設備
High-end 2D/3D Non-contact Laser Scanning Equipment.

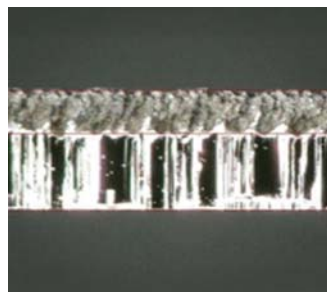


半導體領域 前段切割鑽孔 晶圓製造



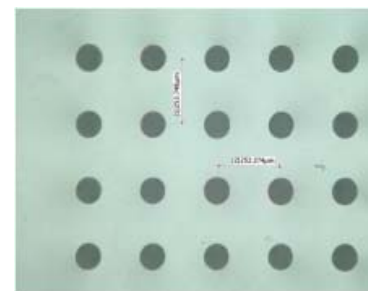
TSV Femto Drilling

TSV飛秒鑽孔機 - 特殊光學套件
進行矽晶圓穿孔與盲孔冷加工



SiC Femto Cutting

SiC飛秒切割機 - 特殊光學套件
進行SiC削蝕冷加工切割



TGV Femto Drilling

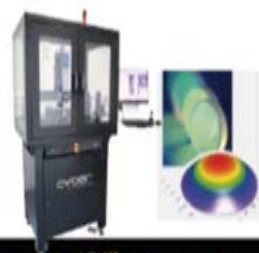
超快雷射技術可達每秒數千孔，
大幅提高生產速度，滿足大批量需求



全球佈局雷科品牌，聚焦核心光電技術，拓展利基藍海市場，提供完整服務方案

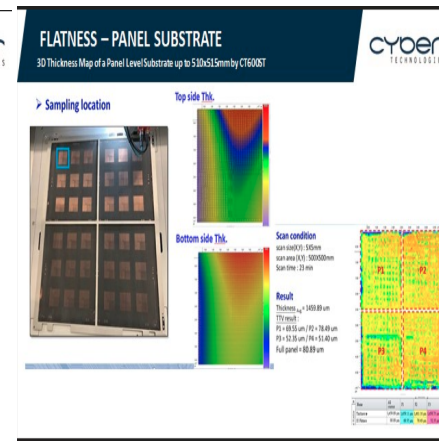
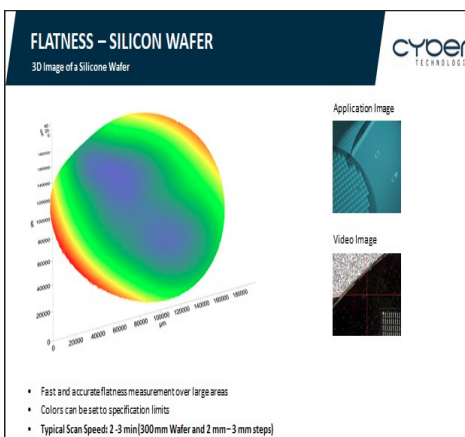
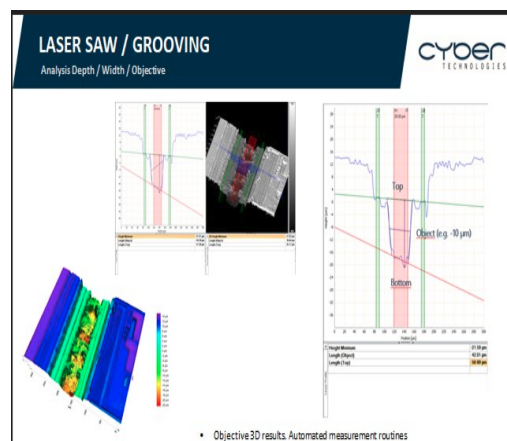
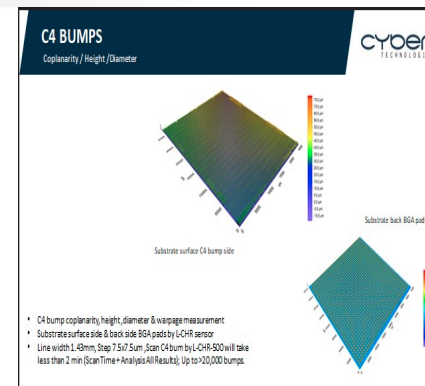
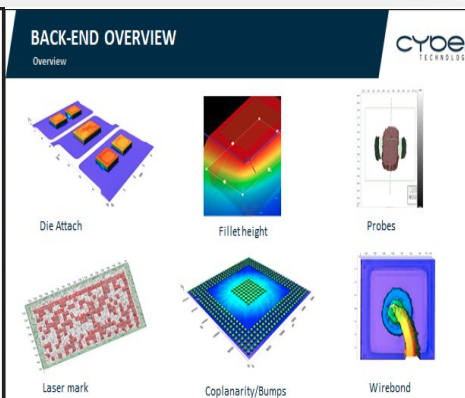
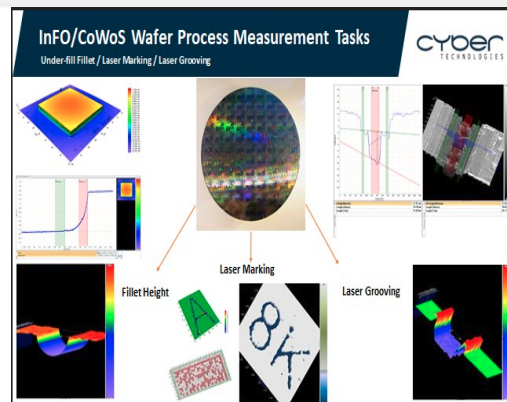
LASER-TEK TAIWAN CO., LTD.

半導體領域 前段 晶圓製造 後段封裝 檢測



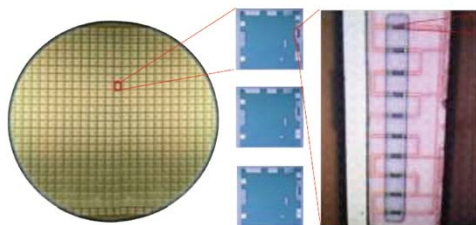
Cyber 設備 Cyber Equipment

高階2D/3D非接觸式雷射掃描設備
High-end 2D/3D Non-contact Laser Scanning Equipment.



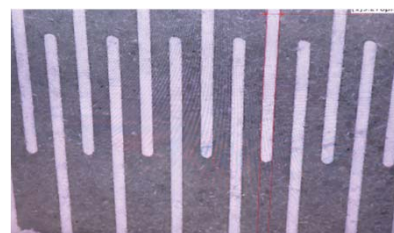
LASER TEK 全球佈局雷射品牌 · 聚焦核心光電技術 · 拓展利基藍海市場 · 提供完整服務方案

➤ 半導體領域 中段測試



Wafer Trim

半導體晶圓修調，On Line
在線即時量測與修調



Functional Trim

混成電路IC功能修調
高精度量測，精密修調



全球佈局雷科品牌，聚焦核心光電技術，拓展利基藍海市場，提供完整服務方案



▶ 半導體領域 後段封裝



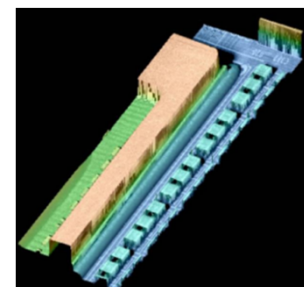
Wafer Marking

深刻、淺刻, 能快速完成晶圓打標, 適合大規模生產線



Laser Deflash

Lead frame 修整去毛邊
四點對位漲縮補償

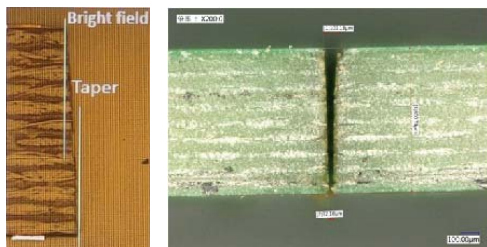


FOPLP

玻璃基板去除膠體, 高精度、非接觸、
無損、高效率, 能精準移除殘膠

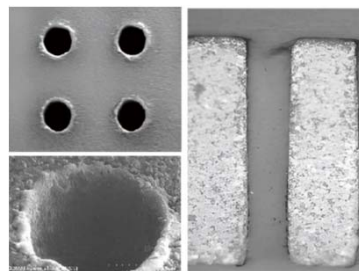


載板應用 雷射應用相關設備--- 高階半導體封裝載板/軟硬複合板



FR4 & ABF 雷射切割&雷射厚core鑽孔

封裝基板層間導通孔 (Via Hole)
ABF 層微孔鑽孔 Substrate 外形切割/分板
多層結構材料精密開窗與去除



RF High Frequency Substrate

高頻RF散熱載板 – 低軌衛星(LEO)應用



高精度複合板切割 消費電子板材 雷射切粒



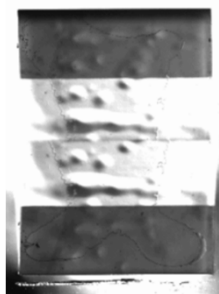


AI智慧應用

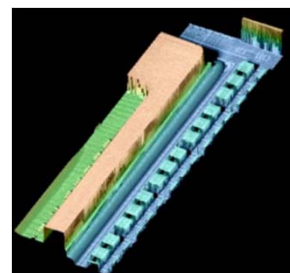
雷射應用相關設備--- AI+AOI+雷射



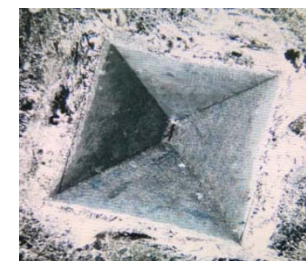
AI缺陷檢查
各類元件雷射應用



AI 透明輪廓建構
VR/AR 玻璃切割應用



AI 膠體高度輪廓
AI晶片除膠應用



AI視覺辨識
光反材質雷射應用





持續創新改善 全員追求卓越

感謝您的蒞臨

Thank you for coming here today.

LASER TEK TAIWAN CO., LTD.